

中钨高新材料股份有限公司 关于金洲公司微钻智能制造1.4亿支技改项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开了第十一届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于金洲公司微钻智能制造1.4亿支技改项目的议案》。为进一步扩大微钻市场占有率、巩固市场地位、提升企业竞争力、促进企业高质量发展，公司控股子公司深圳市金洲精工科技股份有限公司（以下简称“金洲公司”）拟实施微钻智能制造1.4亿支技改项目，具体情况如下：

一、项目投资概况

1. 项目将在金洲公司现有厂房实施，预计总投资1.78亿元，建设期三年，第四年达产。

2. 本次投资建设的资金来源为金洲公司自筹资金，后续如需改变资金来源，将根据规定履行相应审批程序。

3. 本次投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东会审议。

二、项目基本情况

（一）项目建设必要性

我国电子信息产业处在持续稳步增长的时期，电子信息产业的快速发展为 PCB 的发展提供了广阔的市场，也使得 PCB 用微钻的需求呈快速增长的趋势。金洲公司前期建设的提容扩产 2 亿支微钻技术改造项目技改扩产部分新增产能已于 2024 年底完成建设，目前产能无法满足市场的需求。

（二）项目建设内容

一是增加关键加工设备，提升自动化和智能化制造水平。

二是调整产品结构，重点发展涂层微钻、小直径及加长微钻，产品质量达到国际先进水平。

项目达产年，新增微钻产能 1.4 亿支。

（三）项目效益分析

投资效益：经初步测算，项目将实现增量投资财务内部收益率（所得税后）14.79%。

社会效益：项目实施后，将促进企业生产技术水平的提高，扩大生产规模，满足市场需求，提高市场占有率；新增工人和技术人员岗位需求，可创造就业机会减轻社会就业压力；降低生产能耗，节能减排。

三、对公司的影响

本项目建成后有利于金洲公司进一步扩大微钻市场占有率、巩固市场地位、拓展产业空间、夯实发展基础、提升市场竞争力，具有显著的社会效益和较好的经济效益。预计项目短期内不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响。

四、风险提示

前述投资项目是公司基于当前市场前景而作出的判断，可能受国内外市场环境、行业竞争格局、主要原材料供应及价格波动、技术替

代及流失、行业政策调整等诸多因素影响，存在实施进度不达预期、业务拓展不理想等方面的风险，项目预期收益存在不确定性。公司将积极采取有效措施应对风险。公司将根据项目实施进展及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第十一届董事会第三次（临时）会议决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十九日